

【ご案内】

第一回 Semicon India 2026 出展説明会及び インド半導体市場の現状と展望セミナー

【インド市場への具体的な進出方法】

—「セミコンインディア 2026 ジャパンパビリオン出展募集」—

< Semicon India 2026 / 9月17日～19日 / ニューデリー >

2026年4月28日（火）14:00～17:45（セミナー） / 17:45～19:30（懇親会）

インド電子・半導体工業会（IESA）主催

■ お申し込み

▶ セミナー 及び 懇親会 参加申し込み： [\(リンク\)](#)

▶ Semicon India 2026 展示会出展申し込み： [\(リンク\)](#)

【場所がなくなり次第締め切りとなります。早急にお申し込みください】

▶ Semicon India 2026 出展募集資料： [\(リンク\)](#)

各位

平素より大変お世話になっております。

この度、インド電子・半導体工業会（IESA）主催「第一回 Semicon India 2026 ジャパンパビリオン出展説明会及びインド半導体市場の現状と展望セミナー」を開催いたします。セミナー後には懇親会も予定しておりますので、あわせてご参加ください。

■ 開催概要

日時	2026年4月28日（火）14:00～17:45（セミナー） / 17:45～19:30 懇親会
会場	プラザエフ（〒102-0085 東京都千代田区六番町 15 番地）
形式	会場開催 + オンライン配信（ハイブリッド）
参加費	参加費無料（セミナー、及びレセプション）※必ず事前申し込みが必要です。
お申込期日	第1回：4月17日（金） / 第2回：4月24日（金） セミナー限定 120名 （お申し込みが多い場合は、1社2名様までとさせていただきます。） 懇親会限定 60名

■ 主催・後援

主催	インド電子・半導体工業会 (IESA)
共催	NPO 法人 日本インドビジネスビューロー (JIBB) / JIBB India 日印半導体コミティー(JISC) / JISC India
特別後援	精密工学会「プラナリゼーション CMP とその応用専門委員会」
後援	株式会社 FOURIN (フォーイン) Indobox 株式会社
特別協力	グローバルネット株式会社 (GNC)
協カメディア	日刊工業新聞 (予定)
運営事務局	日印コンサルティング株式会社 (JIC)

■ プログラム

時間	登壇者 (所属)	内容
14:00-14:05 (5分)	日印半導体コミティー (JISC) / 株式会社 東邦鋼機製作所	開催挨拶 鈴木辰俊氏 (日印半導体コミティー 会長 / 株式会社 東邦鋼機製作所 会長)
14:05-14:10 (5分)	グローバルネット 株式会社 (GNC)	ご挨拶 武野泰彦氏 (代表取締役社長)
14:10-14:15 (5分)	インド電子・半導体工業 会 (IESA)	ご挨拶 President Ashok Chandak 氏 (オンライン登壇)
14:15-14:45 (30分)	精密工学会「プラナリゼ ーション CMP とその応用 専門委員会」 (略称・CMP 専門委員会)	ご挨拶 —CMP 専門委員会の設立経緯・紹介を含めて— ○土肥俊郎氏 (九州大学 名誉教授 / CMP 専門委員会 創設者・名誉会長) 木下正治氏 (工学博士/ CMP 専門委員会・首席顧問、元副委員長/元・東芝/ 技監、ニッパース/社長)
14:45-15:15 (30分)	精密工学会「プラナリゼ ーション CMP とその応用 専門委員会」 (略称・CMP 専門委員会)	半導体世界情勢 と CMP 装置 ○檜山浩國氏 (荏原製作所(株)技監/CMP 専門委員会・名誉委員長、前委員長) 黒河周平氏 (九州大学教授/ CMP 専門委員会・委員長) 近藤誠一氏 (株)レゾナック・フェロー/ CMP 専門委員会・副委員長)
15:15-16:15 (60分)	インド電子・半導体工 業会 (IESA)	インド市場の現状と展望 President Ashok Chandak 氏 (オンライン登壇)
16:15-16:25 (10分)		Semicon India 2026 ビデオ紹介
16:00-16:20 (20分)	インド電子・半導体工業 会 (IESA)	Semicon India 2026 展示会説明 IESA (オンライン登壇)

16:20-16:40 (20分)	株式会社 東邦鋼機製作所	インド進出から一年での実績評価 西村拓也氏 (事業統括部長)
16:40-17:00 (20分)	日印半導体コミティー (JISC)	インドセミコンの流れ 穂谷宜親氏 (ディレクター)
17:00-17:15 (15分)	Green PMU Semi Private Ltd. / Indobox / 日印半導体コミティー (JISC)	日印間での半導体産業を加速させるため提案、方法、 高度人材について サイ・チャンドラ・テジャ氏 (Green PMU Semi Private Ltd. Co-Founder COO / Indobox パートナー / 日印半導体コミティー (JISC委員))
17:15-17:30 (15分)	NPO 法人 日本インドビ ジネスビューロー (JIBB) /日印半導体コミッティ ー(JISC)	セミコンインディア「ジャパンパビリオン」のメリット、日印半導体コミティーの機能紹介、日印半導体ビジネスセンター開設—365 日常設展示ショーケースについての活用方法、インド IT 人材の雇用について。 安井重磨氏 (CEO)
17:30-17:45		質疑応答
17:45-19:30		レセプション (懇親会)

■ セミナーの見どころ

【1】【IESA】インド半導体市場の現状と展望 & Semicon India 2026 展示会のご紹介

インド電子・半導体工業会 (IESA) より、インド半導体産業の現状と今後の成長戦略についての最新情報をご紹介します。インドの半導体エコシステムの発展やビジネスチャンスについて解説いただく、必見の内容です。また、Semicon India 2026 展示会の概要と最新情報をご紹介します。

【2】九州大学名誉教授 土肥俊郎氏による講演

超精密加工専門委員会 (CMP 専門委員会) 創設者・名誉会長であり、九州大学名誉教授の土肥俊郎氏より、ご挨拶とともに CMP 専門委員会の沿革・活動内容についてご紹介いただきます。半導体製造の基盤技術である CMP (化学的機械的研磨) 分野における日本の研究・産業界の取り組みと CMP に関する国際会議 ICPT の紹介とともに、インドにおける半導体プロセス・CMP 技術に関する研究会設立を目指す牽引力となることにも言及します。

【3】荏原製作所株式会社技監 檜山浩國氏による講演「半導体世界情勢と CMP 装置」

プラナリゼーション CMP 専門委員会 の前委員長 (名誉委員長) であり、荏原製作所株式会社技監の檜山浩國氏より、世界の半導体産業の最新情勢とキーとなるプラナリゼーション CMP 技術の概要と CMP 装置の現状と将来技術動向について解説いただきます。半導体製造プロセスにおける CMP 技術の重要性と、グローバル市場における CMP 装置の最新トレンドを基礎から応用までを把握できる必見の内容です。

【4】【株式会社東邦鋼機製作所】インド進出から一年での実績評価

前回 Semicon India 2025 に出展された株式会社東邦鋼機製作所より、インド進出から一年での実績評価をお届けします。出展をご検討の企業様にとって貴重な情報源となります。

【5】【サイ. チャンドラ. テジャ氏】日印間での半導体産業を加速させるため提案、方法、高度人材について

IIT ハイデラバード校卒業。大阪大学 PhD。東芝、Kioxia にて研究経験をつみ、帰国後インドの半導体スタートアップの会社を起業。今回のセミナーでは日印間での半導体産業を加速させるため提案、方法、高度人材についてなどをご紹介します。

【6】【JISC / JIBB】日印半導体協力の未来と JISC ビジネスセンター開設のご案内

日印半導体コミティ（JISC）および JIBB より、日印半導体コミティの機能紹介、日印半導体ビジネスセンター開設—365 日常設展示ショーケースについての活用方法、インド IT 人材の雇用について、また、セミコンインディア「ジャパンパビリオン」に参加することのメリットをご紹介します。

※アンケートにお答え頂けましたらセミナー資料（一部お渡しできない資料あり）お渡し致します。

インドは現在、半導体産業の急速な発展を遂げており、日本企業にとって大きなビジネスチャンスが広がっています。本セミナーは、インド半導体市場への参入・拡大を検討されている企業様はもちろん、エレクトロニクス・AI 関連でインドとのビジネスを模索されている企業様にも、大変有益な内容となっております。

ご質問・お問い合わせがございましたら、下記事務局までお気軽にご連絡ください。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

【お問い合わせ先】

インド半導体ビジネス進出セミナー事務局

NPO 法人 日本インドビジネスビューロー（JIBB）

日印コンサルティング株式会社

担当：安井・橋倉

E-mail：trade@ji-consulting.jp

TEL：090-9325-3456（安井）／080-6516-4331（橋倉）